

证券代码：301217

证券简称：铜冠铜箔

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-002

|             |  |
|-------------|--|
| 投资者关系活动类别   | <input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议<br><input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会<br><input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动<br><input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议<br><input type="checkbox"/> 其他：____（请文字说明其他活动内容）   |
| 参与单位名称及人员姓名 | 【宏鼎财富】李小斌；【海富通基金】刘海啸；【途灵资产】赵梓峰、符娟娟；【中邮保险】张文鹏、陈思羽；【中融基金】张书玮；【胤胜资产】朱祈之；【景顺长城基金】李南西；【富安达基金】余思贤；【太平基金】宋小浪；【新思哲投资】谢鸣远；【华润元大基金】哈含章；【玖歌投资】程崇；【中银基金】罗庆；【易鑫安资管】舒斌；【信达澳亚基金】魏冠达、杜开欣；【成泉资本】张沛；【嘉实基金】谢泽林；【合众资产】伍颖；【永赢基金】于航；【太平洋资产】高杨、施隽；【中信证券】黄哲；【丹羿投资】张昭丞；【友邦寿险】周广山；【征金资本】谢丰；【聚鸣投资】钱子毅；【巽升资产】黄春雨；【鹏万私募证券基金】梁悦芹；【海南鸿盛私募基金】俞海海；【广汇缘资产】曹海珍；【风炎私募基金】徐余颀；【复需投资】韩守晖；【聂丰私募基金】陈渊；【前海佰德纳】邓轶；【建信信托】余雷；【信普资产】杨如丰；【国华兴益保险】刘旭明；【龙航资产】蔡英明；【厦门财富管理顾问】卢杰；【正圆私募基金】张萍；【勤辰私募基金】杨晋；【泰康基金】陆建巍；【宇泽（武汉）私募基金】包振东；【中泰证券】于柏寒；【华福证券】王保庆 |
| 时间          | 2023年7月3日-7月7日   |
| 地点          | 公司会议室、电话会  |
| 公司接待人员姓名    | 董秘，财务负责人：王俊林<br>证券事务代表：王宁  |

投资者关系活动  
主要内容介绍

证券事务代表王宁先生向调研机构介绍公司情况：

公司主要从事各类高精度电子铜箔的研发、制造和销售等。主要产品按应用领域分类包括 PCB 铜箔和锂电池铜箔。

PCB 铜箔终端应用于通信、计算机、消费电子和汽车电子等领域。公司生产的 PCB 铜箔产品主要有：高温高延伸铜箔（THE 铜箔）、反转处理铜箔（RTF 铜箔）、高 TG 无卤板材铜箔（HTE-W 铜箔）和极低轮廓铜箔（HVLP 铜箔）等。

锂电池铜箔主要为动力电池用锂电池铜箔、数码电子产品用锂电池铜箔、储能用锂电池铜箔，最终应用在新能源汽车、电动自行车、3C 数码产品、储能系统等领域。

截至目前，公司现有电子铜箔产品总产能为 5.5 万吨/年，其中，PCB 铜箔产能 3.5 万吨/年，锂电池铜箔产能 2 万吨/年；在建锂电池铜箔产能 2.5 万吨/年，其中 1 万吨在铜陵基地处于安装状态，另外在池州的 1.5 万吨的项目目前处于在建状态。

经营情况方面，今年的经营情况相比去年是有所下降，一季度利润总额是 2,594.99 万元，原因是下游增速放缓，铜箔加工费下滑，但由于长期以来和下游的良好合作基础，订单情况正常，基本可以做到平衡产能。

## 二、问答环节

### 1. 铜冠铜箔 3.5um 锂电铜箔成本和工费的情况？

答：3.5um 铜箔目前仍处于研发成功，向下游客户送样对接的阶段，加工费预计比 4.5um 铜箔高。

### 2. 公司的锂电池铜箔产品结构？

答：公司目前生产销售的锂电池铜箔产品中 6um 及 6um 以下规格的铜箔占比超过 80%，其中以 6um 铜箔为主。

### 3. 公司生产的 HVLP 铜箔的情况？

答：HVLP 铜箔具有极低的表面轮廓度，制成 PCB 后，传送信号损失低，阻抗小等优良介电特性。

研发历程上，高频高速电子铜箔作为高频高速 PCB 基板的关键材

|      |   |
|------|---|
|      | <p>料之一，在产业升级中起到重要作用。公司前几年立项研发 HVLP 铜箔，可以提升公司技术水平，打破主要材料靠进口的情况，2022 年公司已向下游客户批量供货，并且得到客户较好的评价。</p> <p>产品方面，HVLP 铜箔相对于其他铜箔的制作难度会高很多，主要可能体现在三个方面：第一，HVLP 铜箔属于极低轮廓铜箔，对于低粗糙度的要求越小越好；第二，HVLP 铜箔在具备合格的剥离强度同时必须具备高耐热性能；第三，带有磁性元素的铜箔在高频高速信号传输过程中会导致损耗大，发热严重，要求开发低磁性处理技术。</p> <p><b>4. 在中国市场上铜箔进口情况及这一块市场规模多大？</b></p> <p>答：2022 年我国进口电子铜箔 10.6 万吨，大部分是高端铜箔，主要是高频高速铜箔，国内这方面做的比较少。</p> <p><b>5. HVLP 的下游应用场景？</b></p> <p>答：HVLP 铜箔主要应用于射频-微波基板、高速数字信号基板和高频特性的模块基板中。</p> <p><b>6. 公司的锂电池用的复合铜箔当下的研发的进展？</b></p> <p>答：公司目前成立了一个专业研发小组，专门去研发复合铜箔，并与第三方合作，已经做出样品。</p> <p><b>7. HVLP 铜箔生产设备和 HTE 铜箔的产线差别？</b></p> <p>答：产线不需要大的变化，需在现有产线上做适当改造，调整工艺参数。</p> <p><b>8. 考虑发展压延铜箔吗？</b></p> <p>答：压延铜箔与电解铜箔的生产技术不同，如果发展压延铜箔，工艺与设计需重新规划，并且压延铜箔市场小，目前没有考虑发展压延铜箔。</p> |
| 附件清单 | 无   |
| 日期   | 2023 年 7 月 10 日   |